

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-10-001

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p> <input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他（线上会议） </p>
<p>参与单位</p>	<p> 交银施罗德基金、富国基金、中信保诚基金、天弘基金、鹏扬基金、招商基金、汇添富基金、安信基金、银华基金、泰达宏利基金、兴业基金、民生加银基金、新华基金、平安基金、南方基金、长信基金、恒越基金、晨壹基金、国联安基金、中邮创业基金、创金合信基金、格林基金、长盛基金、方圆基金（香港）、瑞士银行、广银理财、建信金融、汇华理财、宁银理财、亚太财险、国华人寿、泰康人寿、建信养老金、杭州泽泉投资、北京星石投资、西藏源乘投资、厦门航空投资、广州诚协投资、北京衍航投资、上海弥远投资、上海紫阁投资、上海重阳投资、施罗德投资、上海明河投资、深圳市睿德信投资、深圳清水源投资、北京泓澄投资、鸿道投资、瀚川投资、五矿鑫扬（浙江）投资、上海正心谷投资、星云投资、翊安(上海)投资、东亚联丰投资、淡水泉(北京)投资、拾贝投资、从容投资、凯丰投资、五地投资、北京广聚合投资、百联商投、Point72 HongKong Limited、君和资本、海通国际(上海)股权投资基金、深圳固禾私募基金、海创（上海）私募基金、上海亘曦私募基金、广州云禧私募基金、威灵顿私募基金、海南进化论私募基金、深圳瑞信致远、上海合远私募基金、上海复星、北京启迪、上海德汇集团、弘则弥道(上海)、上海探颐商务咨询、SPQ Asia、慎知资产、裕兰资本、上海睿郡资管、上海宁泉资管、华鑫资管、上海敦颐资管、上汽顾臻(上海)资管、源乐晟资管、银润资管、深圳前海博普资管、北京清和泉资管、大家资 </p>

	管、北京骥才资管、中兵财富资管、百年保险资管、臻一资管、福州三鑫资管、华夏未来资管、上海高毅资管、泰康资管、阳光资管、光大永明资管、国泰君安资管、光大证券资管、建投资管、招商证券资管、浙商证券资管、太平资管、新华资管、中金证券、中信建投、招商证券、西南证券、银河证券、国联证券、国盛证券、万和证券、中邮证券、海通证券、长江证券、安信证券、长城证券、民生证券、野村东方国际证券、瑞银证券、华泰证券、国盛证券、财通证券、上海申银万国证券、中泰证券、开源证券、兴业证券、东方证券、西部证券、东吴证券、东方财富证券、浙商证券、万联证券、华安证券、中航证券、东北证券、瑞信证券（中国）、个人投资者（排名不分先后）
时间	2022年10月27日
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券投资部：王渝、陈小曼、肖晓月、陈卓璜
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司 2022 年第三季度经营情况介绍</p> <p>2022 年第三季度，公司实现营业收入 145,607.09 万元、同比增长 8.18%，整体收入规模保持平稳增长；归母净利润 15,899.08 万元、同比下降 22.35%；扣非净利润 12,875.74 万元、同比下降 31.31%；净利润下降主要系公司 FCBGA 封装基板项目的人工成本及研发投入等筹建成本、珠海兴科投产初期的亏损和员工持股计划费用摊销对整体经营利润造成的拖累。</p> <p>2022 年，公司资本支出较大，费用负担重，对整体经营利润造成阶段性拖累，但这是公司投资扩产的必经阶段。公司战略方向清晰，也对未来做好充分准备，不会影响公司战略的执行。公司将持续加大研发投入以实现技术、产品、客户的持续升级，通过良率、交付、技术的改善提升客户满意度，并最终强化与核心大客户的合作深度和广度。</p> <p style="text-align: center;">二、CSP 封装基板相关行业景气度及未来趋势</p> <p>目前公司 IC 封装基板业务以 CSP 封装基板、BT 材料为主，存储类载板是 CSP 封装基板领域最大的下游市场，应用占比约 2/3，是公司目前主要目标市场。受到疫情、国际局势等因素的影响，PC 和手机行业在今年需求减弱。但 CSP 封装基板的下游应用领域为发展成熟的行业，在常态</p>

下需求总量相对稳定。

从竞争格局来看，BT 封装基板目前国内仅有少数几家公司具备量产能力和稳定的客户资源，兴森科技就是其中一家。行业新进入者需要组建经验丰富的团队，核心设备交付周期长，且从组建团队、拿地建厂、装修调试到产能爬坡、完成大客户认证，保守估计至少需要 2~3 年时间，因此公司预计未来 2~3 年在国内产业链仍具备竞争优势。

三、FCBGA 封装基板产能规划

公司 FCBGA 封装基板项目仍在建设过程中，尚未投产。珠海 FCBGA 封装基板项目规划产能为 200 万颗/月（约 6,000 平米/月），预计于 2022 年底之前完成产线建设，计划 2023 年一季度进入样品试产阶段，二季度启动客户认证，三季度开始进入小批量试生产阶段。

广州 FCBGA 封装基板项目在正常推进中，预计于 2023 年 9 月完成产线建设，四季度进入试产，较原定计划有所提前。

四、宜兴批量板业务介绍

宜兴批量板主要为 8 层以上高、多层线路板，主要应用于 5G、光模块、服务器、安防等领域，目前已通过大客户认证，积累了部分服务器行业头部客户，进入头部客户供应链体系，顺利导入批量订单，随着扩产的推进，批量板营收占 PCB 营收比例将逐步提升。

五、半导体测试板业务介绍

半导体测试板是芯片测试环节的基础耗材，产品应用从晶圆测试到封装后芯片测试各环节，产品类型包括探针卡、负载板和老化板。测试板业务与样板业务经营模式类似，属于多品种、小批量、定制化生产模式，产品单价和附加值较高。目前国内参与企业较少，公司半导体测试板业务在国内规模领先，公司半导体测试板业务的主要经营主体为子公司美国 Harbor 及广州科技，Harbor 在全球半导体测试板整体解决方案领域具有优势地位，主要客户均为全球一流半导体公司。广州科技测试板扩产目标是建设国内最大的专业化测试板工厂，并为美国 Harbor 提供产能支持。

六、Fineline 业务介绍

Fineline 主营业务为 PCB 贸易，供应商主要来源于中国，销售区域以欧洲、以色列为主。Fineline 拥有优秀的管理团队，具备出色的供应

	<p>链管理能力和 IT 支持系统，在欧洲多国主要市场建立了本土化、专业的销售和服务团队，是欧洲前三大 PCB 贸易商之一。</p> <p>七、2022 年第三季度公司毛利率水平有所下滑的原因介绍</p> <p>今年三季度以来，公司所处行业需求下滑明显，导致产能利用率、收入增速下滑，叠加因投资扩产成本支出增加、产品结构占比变化等原因，导致毛利率水平有所下滑，公司将通过加强技术升级、改善工艺，提升生产效率，提升产能利用率，优化产品结构等手段促使毛利率提升。</p> <p>八、公司是否考虑降价</p> <p>公司暂时不考虑通过降价争取订单，目前核心问题是行业下游需求不足。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 10 月 27 日